

Изобретение касается способа грунтования субстрата, который включает приведение субстрата в контакт с грунтовкой, которая подается из источника грунтовки, и осаждение грунтовки на субстрат. В сравнении с другими способами грунтования, грунтование согласно изобретению приводит к лучшим результатам, поскольку осаждение проводят электростатически с помощью электроспиннинга.